

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤勵致有限公司

China Resources Logic Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1193)

公告

概要

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條規定作出。

華潤勵致開展東芝IC封裝服務

華潤勵致有限公司（「華潤勵致」或「該集團」）宣佈該集團的非直接百分之七十五擁有的附屬公司 – 無錫華潤安盛科技有限公司（「安盛」）最近為名列全球半導體廠商第四位的日本株式會社東芝（「東芝」）提供集成電路（「IC」）封裝代工服務。於年初，安盛成功通過東芝嚴格的審核，並開始為東芝量產首批規模化封裝加工 IC。安盛計劃於不久將來迅速提升東芝的 IC 封裝月加工量。

安盛百分之九十九點八五的加工良率達到東芝的質量要求，同時標誌著安盛為海外客戶的 IC 封裝加工量產進入新里程，為未來面對較高檔次的客戶提供更大規模的加工量產奠下良好基礎。

安盛成功通過東芝嚴格的審核過程，印證安盛積極為客戶提升技術及服務，以及其高質素產品規格的成績獲得認同，並達到標準化及系統運行的良好成效。安盛積極發展的封裝加工 IC 技術已達到世界水平，成為其進一步成功拓展龐大規模海外客戶的里程碑，並為迎接日後更大規模化及更高附加值的國際 IC 封裝加工作好準備。

關於安盛

安盛主要提供集成電路封裝及測試的代工服務。安盛為華潤勵致的核心企業之一，亦為與世界第三大半導體封裝測試代工企業 – STATS ChipPAC Limited 合資成立的

中外合資股份有限公司。

於本公告日期，本公司董事如下：-

執行董事 ： 朱金坤先生、王國平先生、王添根先生及陳正宇先生

非執行董事 ： 蔣偉先生、劉燕杰先生及李福祚先生

獨立非執行董事 ： 黃得勝先生、陸志昌先生、高秉強先生及楊崇和先生

承董事會命
華潤勵致有限公司
朱金坤
主席

香港，二零零七年六月二十五日